聯茂電子

2020年第三季營運成果

ITEQ

INNOVATION. TEAMWORK. EXCELLENCE. QUALITY

November 2020

免責聲明

ITEQ

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新

公司簡介

- 成立日期　：1997年4月10日
- 總部地址　：台灣省新竹縣新埔鎮大魯閣路17號
- 實收資本額：NT$33.30億
- 員工人數　：逾3,000人
- 董事長　　：陳進財 先生
- 執行長　　：蔡馨曄 女士
- 主要產品：

  銅箔基板、膠片

  軟性銅箔基板

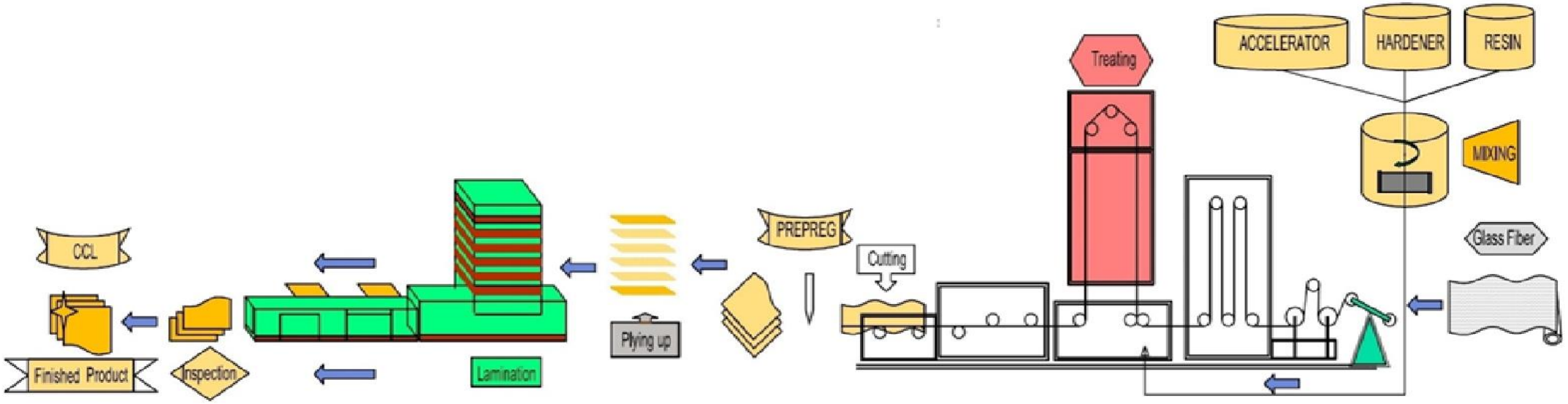
  多層壓合代工

銅箔基板&膠片製造流程

ITEQ

樹脂、填料 → 混合 → 上膠 ← 玻璃布

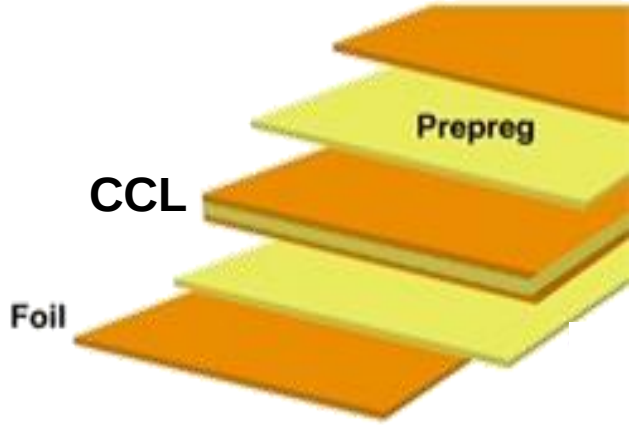
上膠 → 膠片(PP) → 裁切 → 堆疊 ← 銅箔 → 壓合 → 銅箔基板 (CCL)

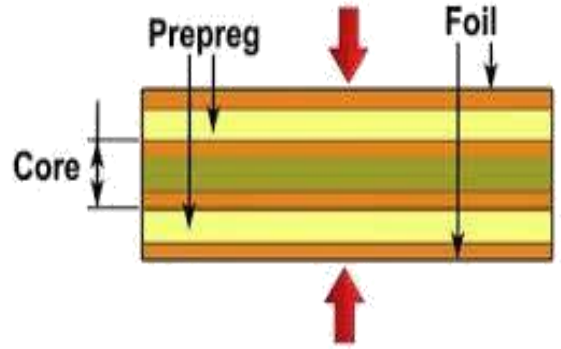


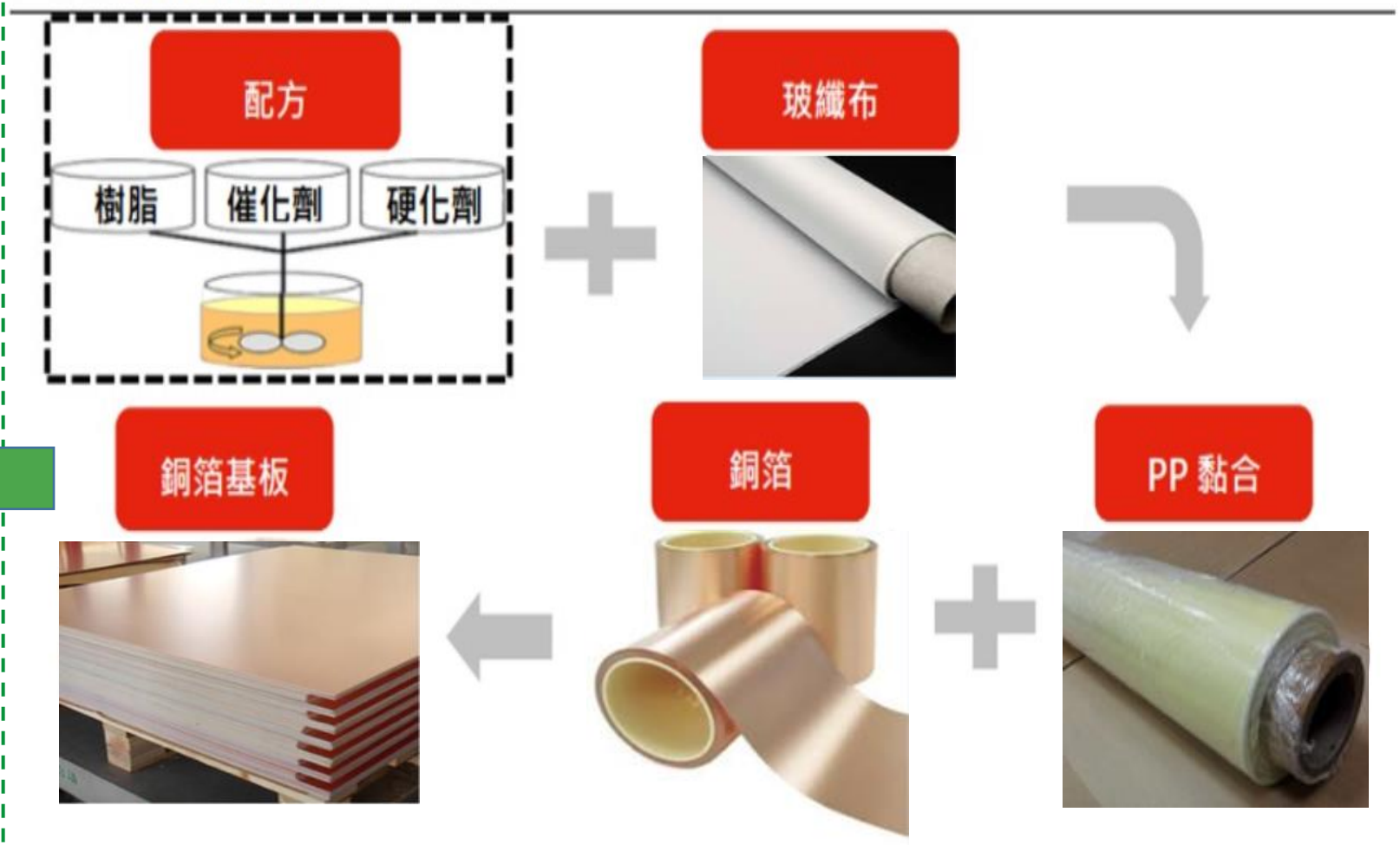
銅箔基板/膠片組成結構

ITEQ

CCL/PP

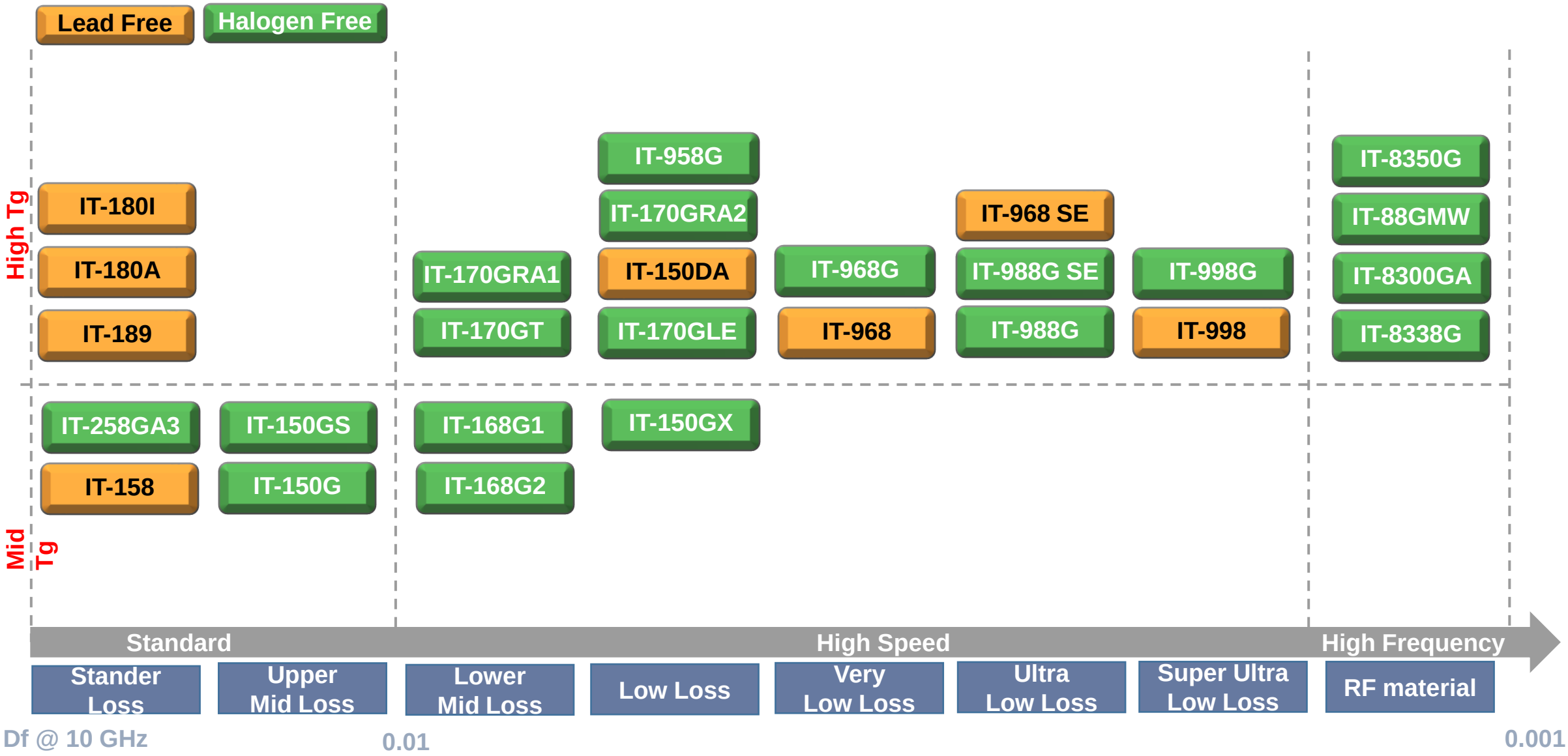






完整的產品線規劃

ITEQ



核心技術

ITEQ

智慧型手機&平板

Low Dk
Ultrathin

網通
資料中心
雲端運算
5G

Controlled Dk and Low Df

材料科學
樹酯配方
精密製程

FR-4
Halogen Free

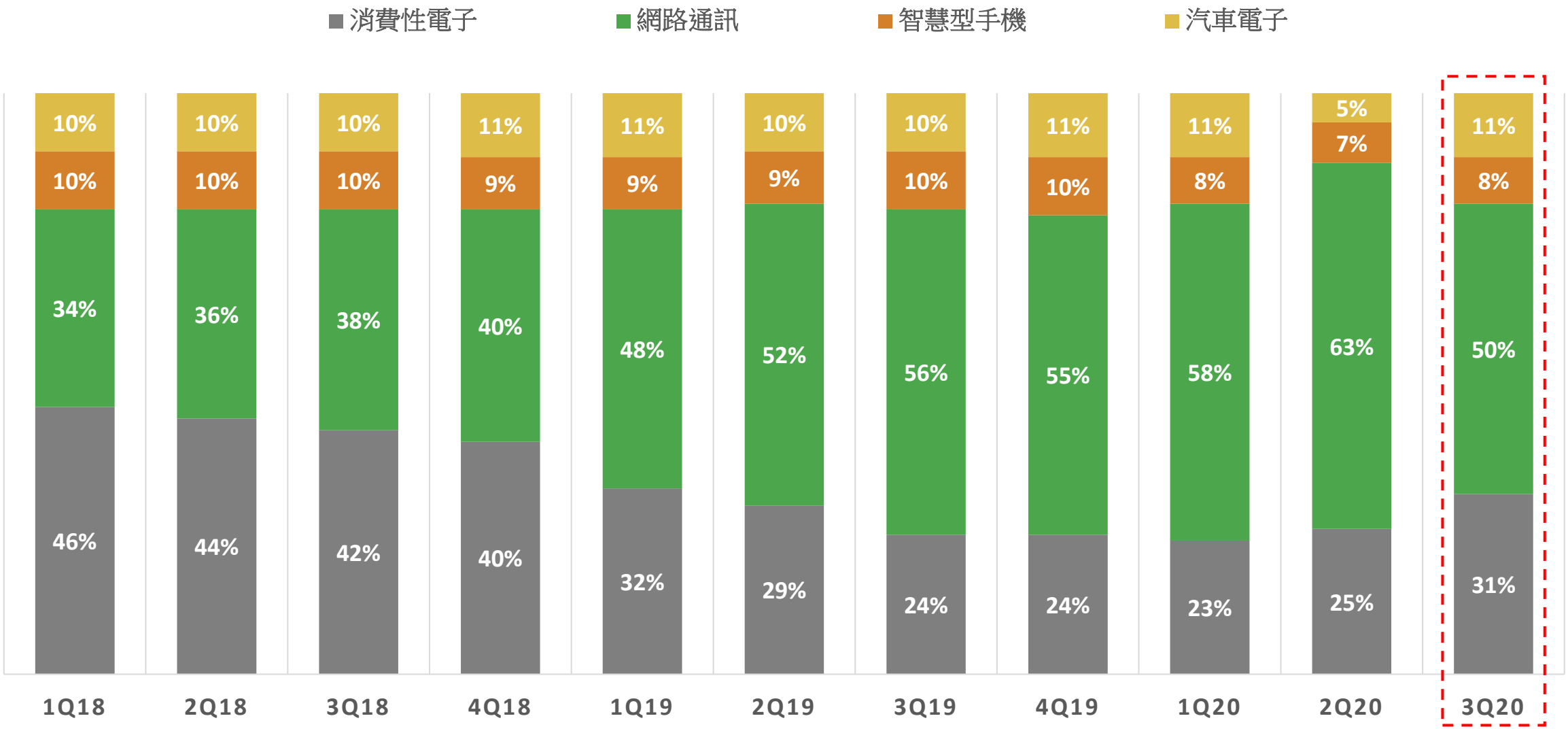
消費性電子

High Reliability

車用電子

1Q18~3Q20產品組合

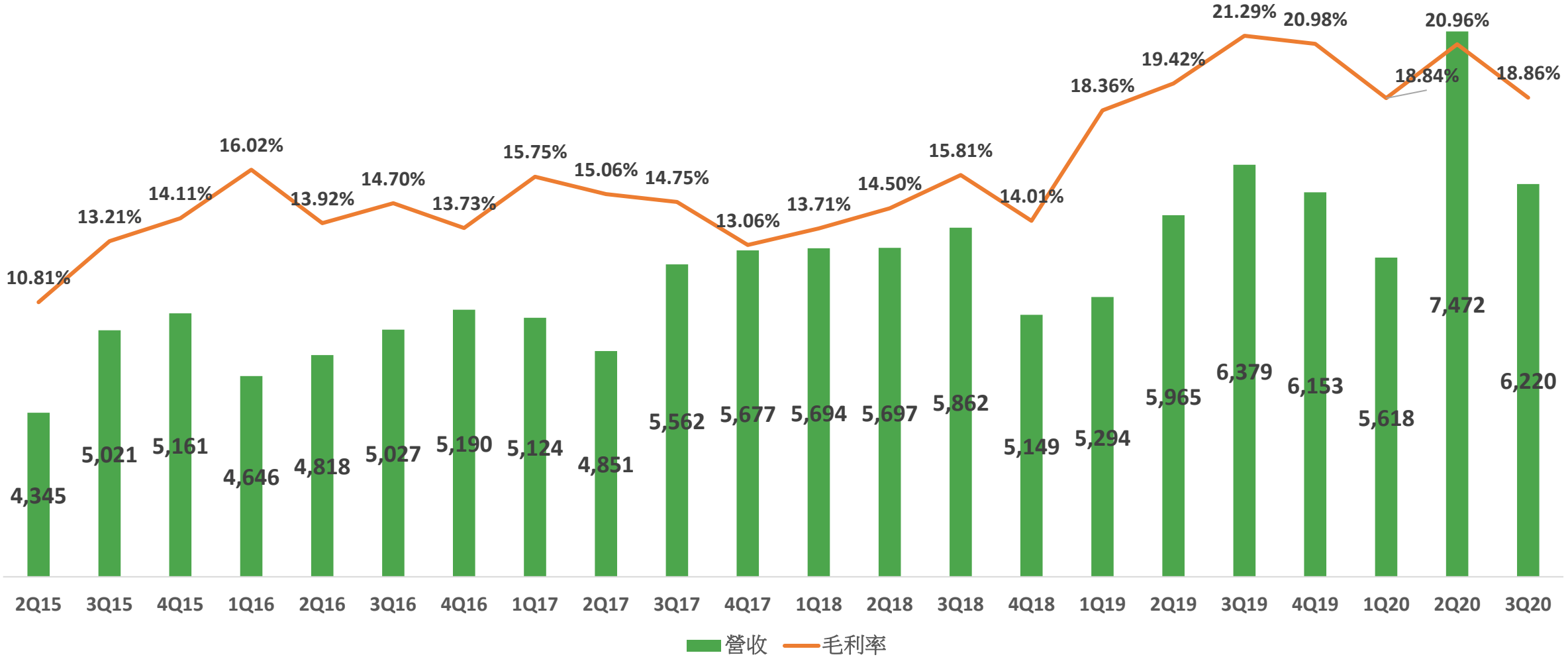
ITEQ



營收 & 毛利率

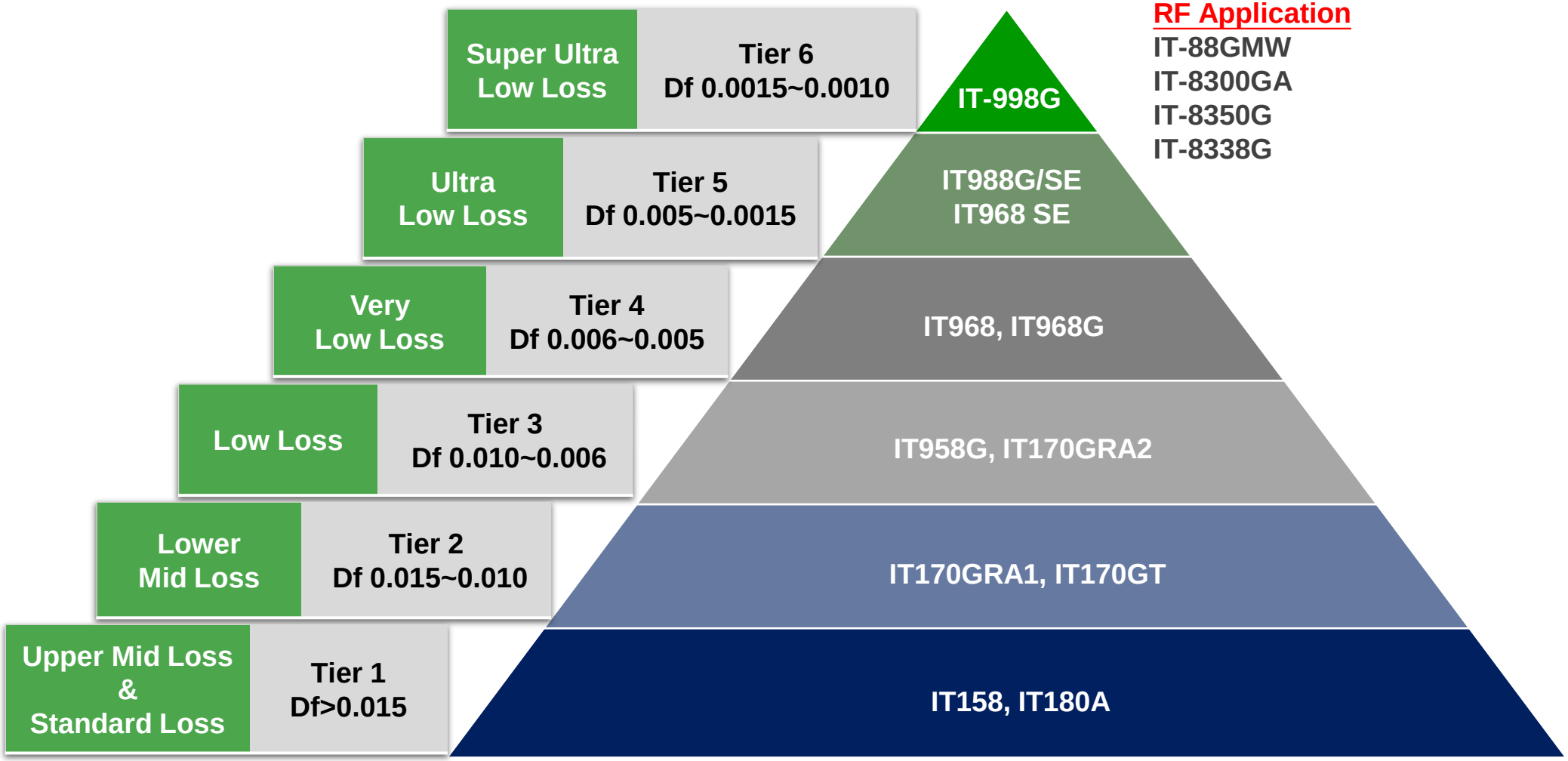
ITEQ

(百萬 NTD)



高階產品布局

ITEQ



RF Application

IT-88GMW
IT-8300GA
IT-8350G
IT-8338G

- 隨著5G商用化、伺服器升級等需求，將帶動高頻高速需求高度成長。
- ITEQ在高頻高速材料市場的市占率將顯著提升。

3Q20 損益表

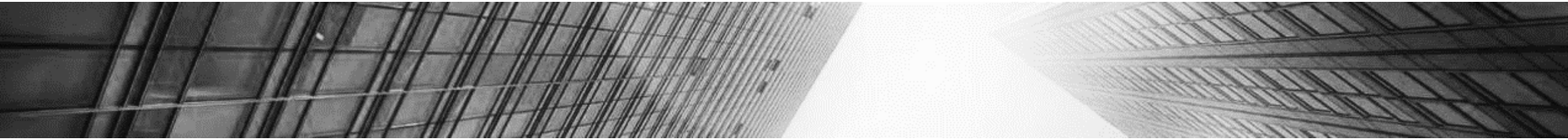
ITEQ

NTD/百萬元	3Q20	2Q20	3Q19	QoQ	YoY
營業收入	**6,220**	**7,472**	**6,379**	-17%	-2%
營業毛利	1,173	1,567	1,358	-25%	-14%
營業費用	454	486	421	-7%	8%
營業利益	**719**	**1,081**	**938**	-33%	-23%
營業外收入及支出	97	(4)	(59)		
稅前淨利	816	1,077	878	-24%	-7%
所得稅費用	172	211	163		
歸屬於母公司之淨利	645	866	715	-26%	-10%
每股盈餘(NTD)	**1.94**	**2.60**	**2.36**	-25%	-18%
重要財務比率					
毛利率	**18.9%**	**21.0%**	**21.3%**		
營業費用率	7.3%	6.5%	6.6%		
營業利益率	**11.6%**	**14.5%**	**14.7%**		
有效稅率	21.0%	19.6%	18.5%		
淨利率	10.4%	11.6%	11.2%		

3Q20 資產負債表

ITEQ

NTD/百萬元	3Q20	2Q20	3Q19
資產總額	**25,953**	**24,433**	**21,929**
現金及約當現金	3,625	2,566	2,984
短期投資	6	11	83
應收帳款/票據	11,200	11,958	10,702
存貨	3,330	3,199	2,110
固定資產/預付設備款	5,896	4,762	4,596
負債總額	**13,527**	**12,861**	**13,476**
短期借款	2,331	1,359	4,242
應付帳款/票據	6,328	6,293	5,715
長期借款	1,640	919	718
股東權益總額	**12,426**	**11,572**	**8,453**
重要財務指標			
應收帳款週轉天數	156	161	151
存貨週轉天數	56	55	37
應付帳款週轉天數	111	109	97
股東權益報酬率(年化)(%)	23.90	25.6	29.20
資產報酬率(%)	10.57	11.2	12.08
負債比(%)	52.12	52.6	61.45



市場趨勢 & 成長動能

ITEQ

市場趨勢-高頻高速傳輸需求與日俱增

ITEQ

全球資料領域加速擴增

- 核心 (傳統 / 雲端資料中心)
- 邊緣運算 (企業強化版基礎建設，如公司機房 & 廠內外伺服器、訊號發射站等等)
- 終端 (電腦、智慧型手機,、IoT 裝置)

全球IP流量高速成長

- 超高畫質(4K/8K)影音串流、線上遊戲下載執行
- 物聯網相關應用 (智慧家庭、遠端醫療與自駕車)
- 大數據分析與人工智慧(AI)
- 雲端運算與雲端儲存
- 虛擬實境(VR) 與擴增實境 (AR)

(Source: Data Age 2025, sponsored by Seagate with data from IDC Global DataSphere, May 2020)

- 全球資料流量大幅提升，帶動網路服務營運商及電信商升級設備來滿足低延遲、高可靠與高速運算處理需求

5G網絡架構及商機

ITEQ

核心網絡升級、傳輸網絡升級:

- 包含 **數據中心、邊緣運算、高速光傳輸**
- **高性能計算、大容量高速**

高速材料

基帶處理單元(DU+CU)

- 實現低訊號延遲, 高速傳輸處理
- 包含 **宏基站** 到 **小基站**

高速材料

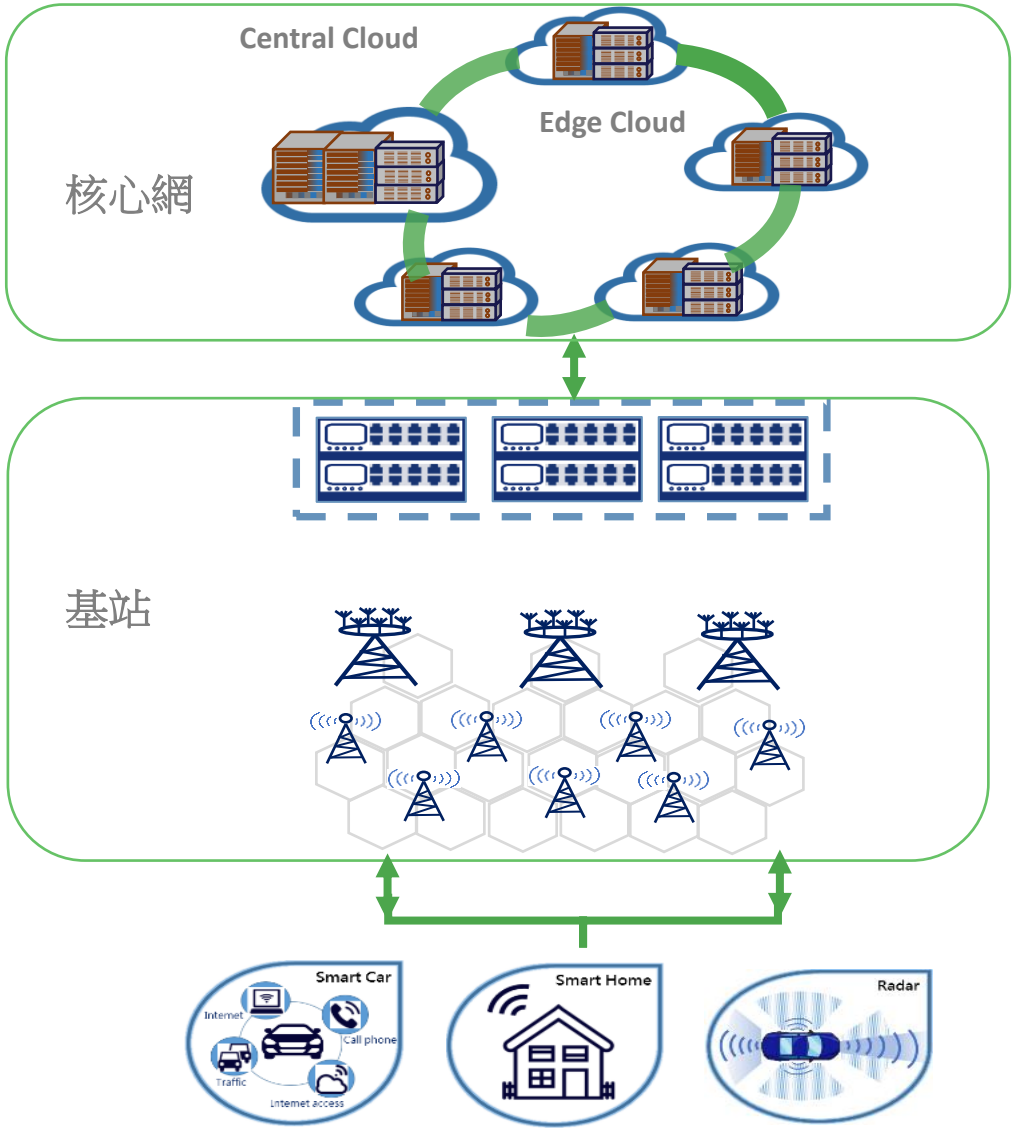
射頻單元(AAU)

- 包含**天線、功率放大器模組**與**射頻模組**
- 高多層設計因應功能複雜化

高速材料 **高頻材料**

IOT(Internet of Things):

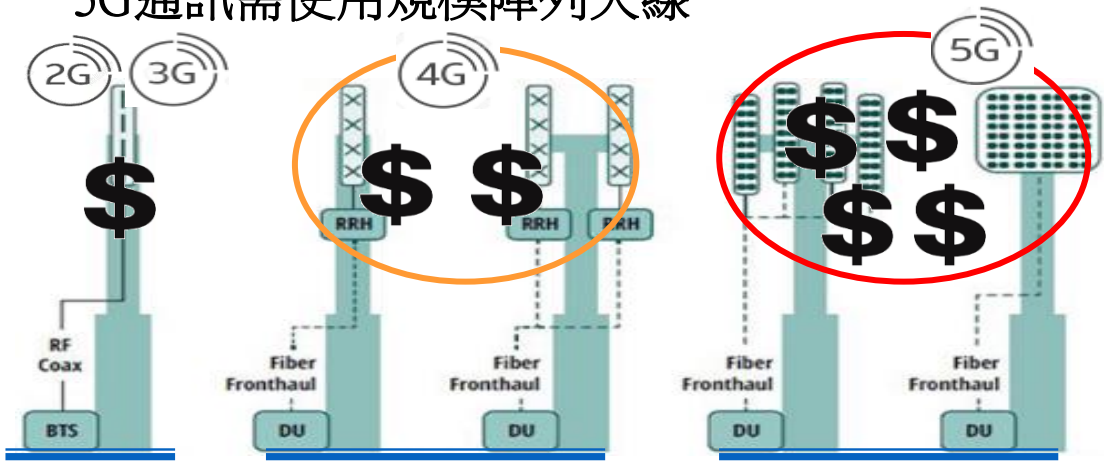
高速材料



可持續的成長動能(Telecom)

ITEQ

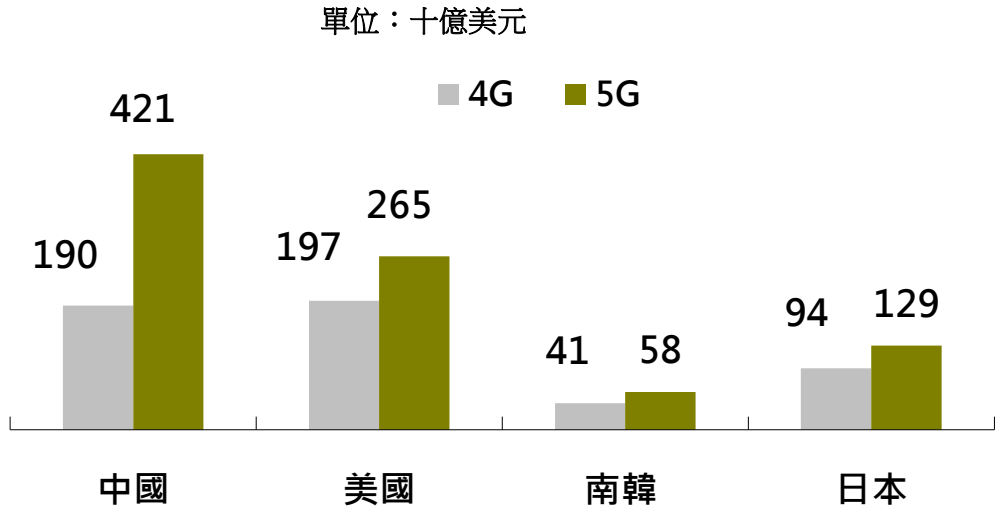
5G通訊需使用規模陣列天線



單天線　2x2/ 4x4 多天線　大規模陣列天線

資料來源：Morgan Stanley，2019/2；DIGITIMES Research整理，2020/8

各國4G與5G CAPEX (10年)預估

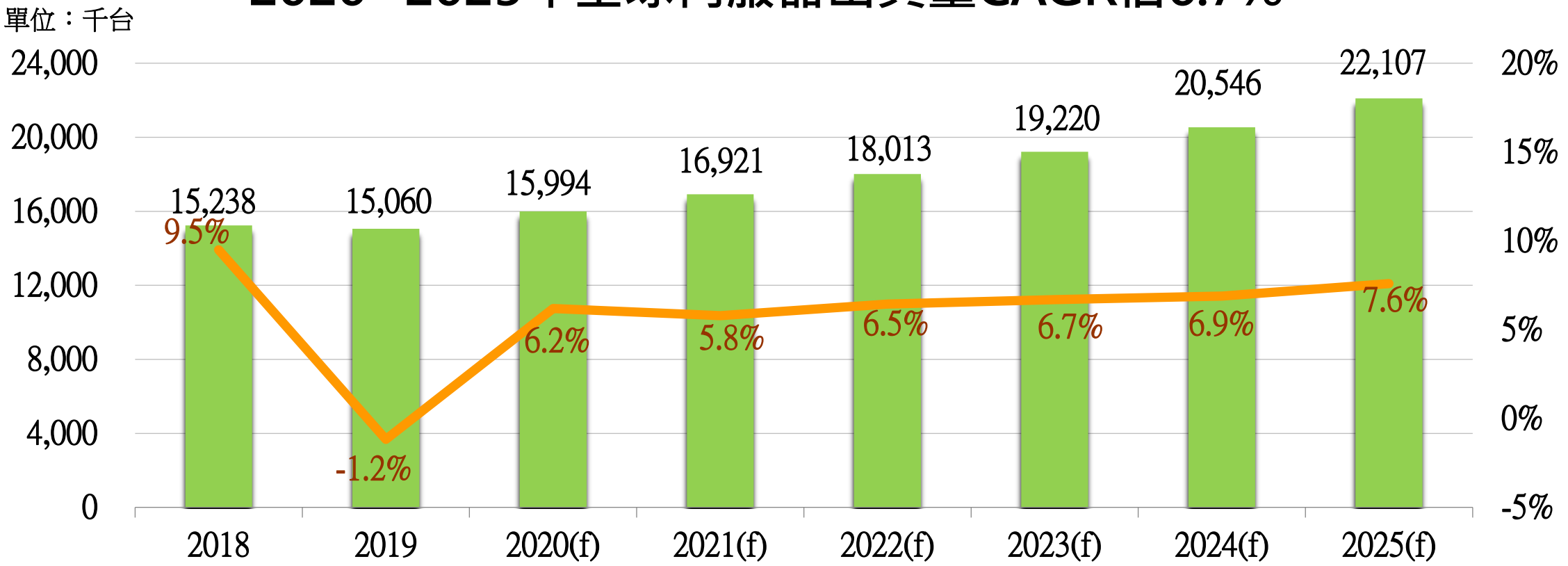


- 高頻譜5G網路：基地台設備放量/升級等需求，帶動市場對高速/高頻產品之需求成長。
- PCB設計複雜化：PCB面積/層數擴增，所需之CCL也相對提升。

可持續的成長動能(Datacom)

ITEQ

2020~2025年全球伺服器出貨量CAGR估6.7%

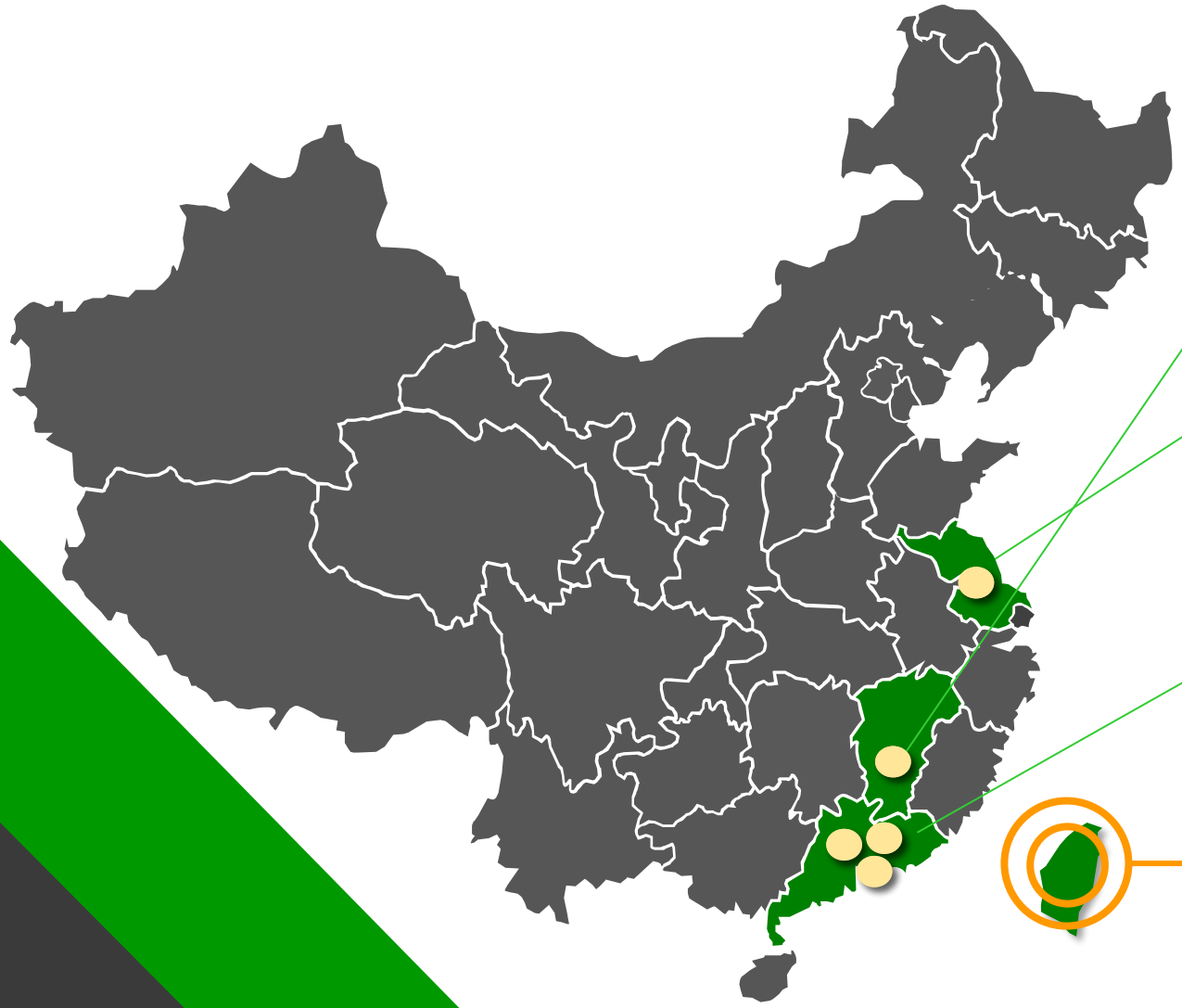


資料來源：DIGITIMES Research，2020/9

- 資料中心設備出貨提升：高速材料需求亦同步持續攀升
- 硬體設備升級：對應之材料亦相對升規

廠區分布與產能

ITEQ



江西廠
(第一期) - 2020
基板 (60萬 張/月)
膠片 (450萬 米/月)
(第二期) - 2021
基板 (60萬 張/月)
膠片 (450萬 米/月)
(第三期) – 時程待確認

無錫廠
基板 (180萬 張/月)
膠片 (850萬 米/月)

東莞廠
基板 (100萬 張/月)
膠片 (450萬 米/月)

廣州廠
3L FCCL(75萬 平方米/月)
2L FCCL(14萬 平方米/月)

黃江廠
壓合代工(50萬 平方呎/月)

台灣新埔廠 (總部)
基板 (45萬 張/月)
膠片 (180萬 米/月)

Distributor/Agent ：USA、Europe、 Israel 、 Korea、Japan、Singapore

2014 – 2019 配息政策

ITEQ

年度	每股盈餘(NT$)	股利(NT$)	現金股利(NT$)	配息率(%)
2014	1.62	1.2	1.2	74%
2015	1.92	1.6	1.6	83%
2016	3.13	2.5	2.5	80%
2017	4.11	3.1	3.1	75%
2018	5.86	3.8	3.8	65%
2019	8.13	5.0	5.0	62%

*於2020年3月31日完成現金增資發行新股3千萬股；目前普通股數約為3.33億股

聯茂 & 三菱合資計劃

ITEQ

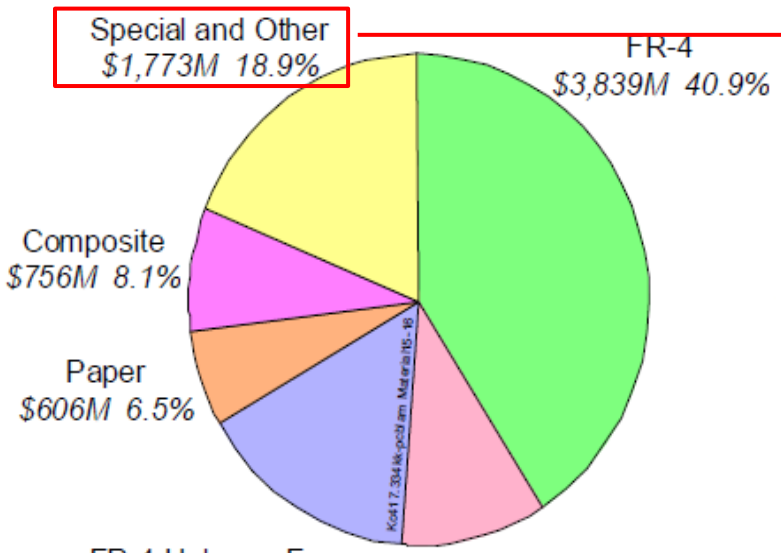
ITEQ
INNOVATION • TEAMWORK •
EXCELLENCE • QUALITY

全球CCL特殊材料產值大幅攀升

ITEQ

全球銅箔基板產值($USD)

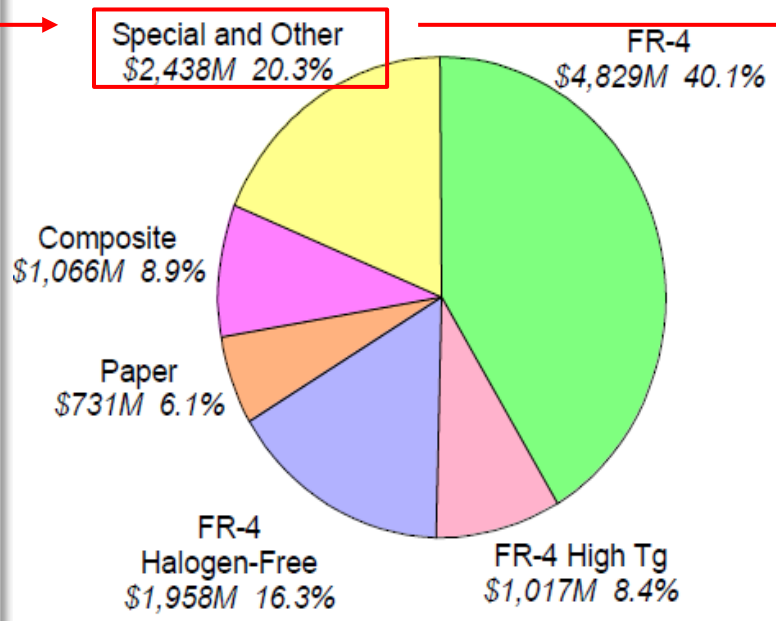
2015



TOTAL: $9,376M

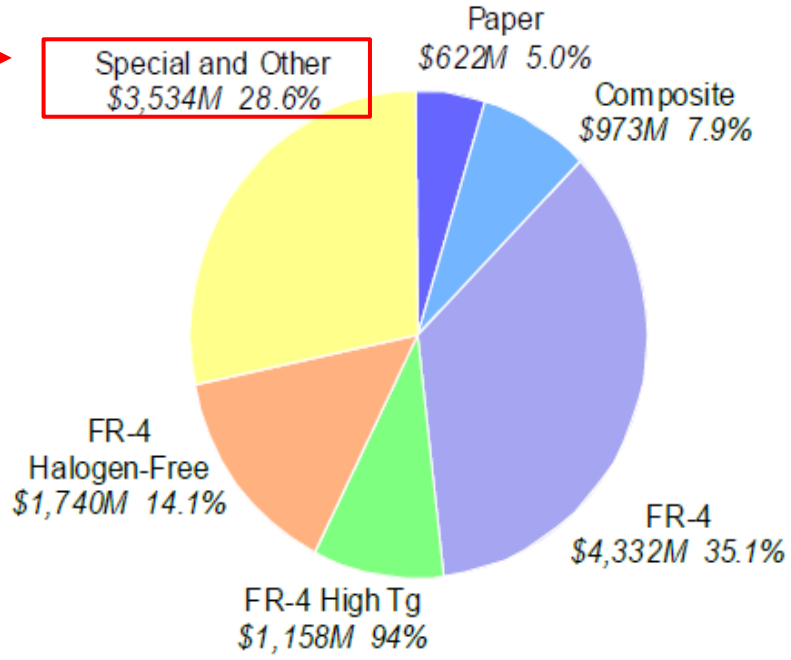
資料來源: Prismark Report

2017



TOTAL: $12,039M

2019



TOTAL: $12,359M

- 高速傳輸帶動下，全球特殊材料產值從2015年的17.73億美元大幅攀升至2019年的35.34億美元
- 高速/高頻CCL技術地位領航下，聯茂也將跨足應用於半導體封裝之載板材料市場

ITEQ x MGC合資案 – IC載板材料

ITEQ

MGC

IC封裝基板

MGC & ITEQ JV

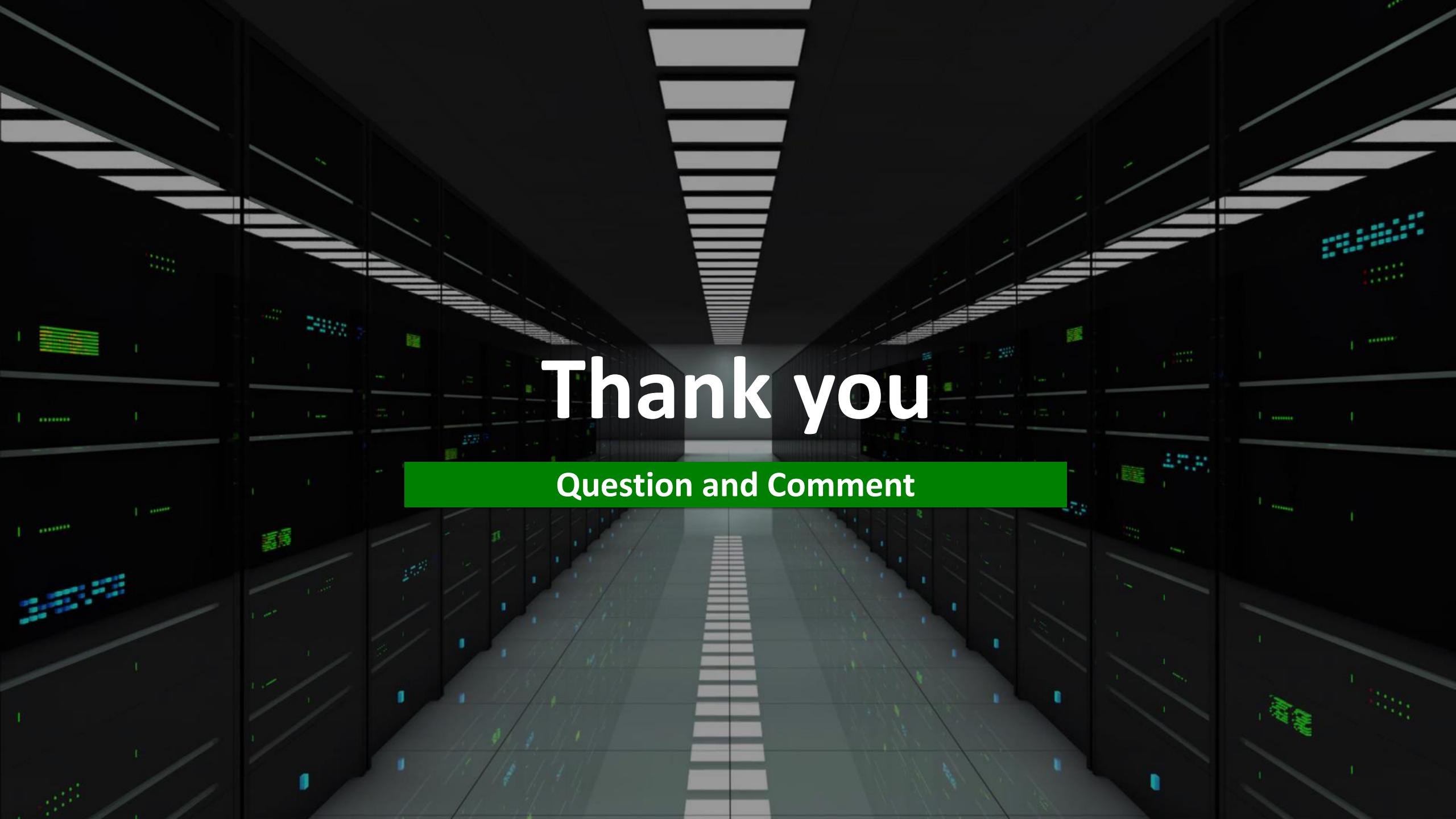
IC載板材料

ITEQ

高速/高頻CCL

BT載板

- 邏輯IC (消費性電子、智慧型手機、GPU、CPU)
- 記憶體IC (DRAM、NAND Flash)



Thank you

Question and Comment